

H100-Soft 超软系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H100-Soft 导热硅胶垫片，热空穴填料具有优良的柔软性、压缩性和自然表面粘度性能。用于填充间隙，实现加热件与冷却件之间的传热。同时具有绝缘和减震效果，具有优良的制造性和实用性。广泛应用于电子产品中。

产品性能

NO.	参 数	单 位	测试方法
颜 色	白色	---	目视
载 体	矽胶布	--	目视
厚 度	1.5~3	mm	ASTM D374
硬 度	10±5	Shore C	ASTM D 2240
密 度	2.35±0.5	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥ 1.5	Mpa	ASTM D 412
延 伸 率	≥ 5	%	ASTM D 412
压 缩 比	≥ 40 (@50psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0,5V	---	UL-94
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	1.0±0.2	W/m·K	ASTM D 5470
热 阻	≤ 3.0 (@20Psi/1.5mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 8	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^8$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥ 2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤ 0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权